

2011-2012年全球及中国半导体封测行业研究报告

《2011-2012年全球及中国半导体封测行业研究报告》包括以下内容：

- 1、全球半导体产业概况
- 2、模拟半导体、MCU、DRAM、NAND、复合半导体产业现状
- 3、IC制造产业现状
- 4、封测产业市场与产业
- 5、24家封测厂家研究

独立的封测厂家通常称之为OSAT或ASAT。1997年时OSAT产业规模只有大约51亿美元，占半导体产业的19.6%。2011年该市场规模为236亿美元。由于TSV技术进展缓慢，且Foundry有意完成部分封装业务，因此未来OSAT市场规模变化不大，仅有微幅增长，预计2012年收入244亿美元。封测市场中封装占大约78%，测试占22%，预计未来IC测试和Wafer Test更加耗时，所占的成本会更高。

封测厂家严重依赖代工厂(Foundry)和IDM厂家，尤其是代工厂，只有依靠规模比



较大的代工厂，封测厂家才能获得比较大的市场。全球第一大封测厂家日月光（ASE）与全球第一大代工厂TSMC两者亲密合作，TSMC几乎所有的IC都是ASE封测的。TSMC在全球Foundry市场占有率大约为48%，ASE在全球封测市场中市场占有率大约18%。全球第二大封测厂家Amkor则与Global foundries配合。全球第三大封测厂家SPIL与UMC配合。全球第四大封测厂家主要为新加坡Chartered和INTEL配套。

全球封测产业集中度比较高，前四大的市场占有率为46%。主要原因是这些厂家获得了大型代工厂的鼎力支持。由于台湾的晶圆代工产业高度发达，全球市场占有率超过60%，因此台湾的封测产业也异常发达，全球市场占有率达56%。

由于新加坡Chartered和日本IDM厂的带动，东南亚企业占据了第二的位置，市场占有率达15%，不过Chartered被Global foundries收购后业绩停滞不前，东南亚企业的产品多以模拟IC封测为主，缺乏成长空间，未来肯定下滑。

美国厂家从事高端产品封测，美国境内也有数量众多的Foundry和IDM厂，因此占据第三的位置，市场占有率达13%。韩国封测企业则依赖三星和SK Hynix，未来三星无论是内存还是System LSI都能保持不错的增长，因此韩国企业前景良好。



2008-2012年全球24大封测厂家收入(百万美元)

中国大陆的Foundry较多，但大多技术落后，连带使得封测企业规模不大，业绩不佳。2011年中国第一大封测企业长电科技运营利润暴跌了97.3%；第二大封测企业南通富士通微电子运营利润大跌了89.5%。而全球前4大封测企业的运营利润平均跌幅大约是18%。

	Headquarter	2010	2011	2012E
ASE	台湾	4080	4339	4691
AMKOR	美国	2939	2776	2758
SPIL	台湾	2018	2078	2158
StatsChippac	新加坡	1678	1707	1898
PTI	台湾	1196	1339	1509
UTAC	马来西亚	938	958	952
Shinko	日本	773	688	660
J-devices	日本	593	608	656
ChipMOS	台湾	569	602	608
JCET	中国大陆	534	582	588
Chipbond	台湾	360	449	482
KYEC	台湾	450	391	435
FATC	台湾	374	402	407
STS Semiconductor	韩国	317	371	388
Unisem	马来西亚	432	380	360
Carsem	马来西亚	394	332	302
Greatek (已被 PTI 收购)	台湾	323	302	
Signetics	韩国	203	243	296
Hana Micron	韩国	230	258	295
Nepes	韩国	243	242	291
Walton	台湾	285	278	264
Nantong Fujitsu	中国大陆	254	248	250
Lingsen	台湾	201	198	212
TIANSHUI HUATIAN	中国大陆	172	203	208

来源：水清木华《2011-2012年全球及中国半导体封测行业研究报告》



报告目录

第一章、全球半导体产业

- 1.1、全球半导体产业概况
- 1.2、IC设计产业
- 1.3、IC封测产业概况
- 1.4、中国IC市场

第二章、半导体产业格局

- 2.1、模拟半导体
- 2.2、MCU
- 2.3、DRAM内存产业
 - 2.3.1、DRAM内存产业现状
 - 2.3.2、DRAM内存厂家市场占有率
 - 2.3.3、移动DRAM内存厂家市场占有率
- 2.4、NAND闪存
- 2.5、复合半导体产业

第三章、IC制造产业

- 3.1、IC制造产能
- 3.2、晶圆代工
- 3.3、MEMS代工
- 3.4、中国晶圆代工产业
- 3.5、晶圆代工市场
 - 3.5.1、全球手机市场规模
 - 3.5.2、手机品牌市场占有率
 - 3.5.3、智能手机市场与产业
 - 3.5.4、PC市场
- 3.6、IC制造与封测设备市场
- 3.7、半导体材料市场

第四章、封测市场与产业

- 4.1、封测市场规模
- 4.2、封测产业格局
- 4.3、WLCSP市场
- 4.4、TSV封装



4.5、半导体测试

4.5.1、Teradyne

4.5.2、Advantest

4.6、全球封测厂家排名

第五章、封测厂家研究

5.1、日月光

5.2、Amkor

5.3、硅品精密

5.4、星科金朋

5.5、力成

5.6、超丰

5.7、南茂科技

5.8、京元电子

5.9、Unisem

5.10、福懋科技

5.11、江苏长电科技

5.12、UTAC

5.13、菱生精密

5.14、南通富士通微电子

5.15、华东科技

5.16、颀邦科技

5.17、J-DEVICES

5.18、MPI

5.19、STS Semiconductor

5.20、Signetics

5.21、Hana Micron

5.22、Nepes

5.23、天水华天科技

5.24、Shinko



图表目录

- 2010-2013年全球半导体封装材料厂家收入
- 2007-2011年中国IC市场规模
- 2011年中国IC市场产品分布
- 2011年中国IC市场下游应用分布
- 2011年中国IC市场主要厂家市场占有率
- 2011年模拟半导体主要厂家市场占有率
- 2011年Catalog 模拟半导体厂家市场占有率
- 2011年10大模拟半导体厂家排名
- 2011年MCU厂家排名
- 2000-2012年DRAM产业CAPEX
- 2000-2013年全球DRAM出货量
- 2009年10月-2012年1月DRAM合约价涨跌幅
- 2005年1季度-2012年4季度全球DRAM厂家收入
- 2010年1季度-2012年4季度全球DRAM晶圆出货量
- 2001-2013年 系统内存需求量
- 2011年4季度Dram品牌收入排名



- 2009-2011年Mobile DRAM 市场份额
- GaAs产业链The GaAs Based Devices Industry Chain
- GaAs产业链主要厂家
- 2011-2012年全球GaAs厂家收入排名
- 2011年全球12英寸晶圆产能
- 1999-2012年全球12英寸晶圆厂产能地域分布
- 2011年4季度-2012年4季度主要Fab支出产品分布
- 2010年1季度-2013年4季度全球晶圆加载产能产品分布
- 2010-2012年全球晶圆设备开支地域分布
- 2005-2011年全球Foundry销售额排名
- 2005-2011年全球主要Foundry运营利润率
- 2011年全球前30家MEMS厂家收入排名
- 2011年全球前20大MEMS Foundry排名
- 2011年中国Foundry家销售额
- 2011年全球前25家IC设计公司排名
- 2007-2014年全球手机出货量
- 2009年1季度-2011年4季度每季度全球手机出货量 与年度增幅
- 2010-2012年3G/4G手机出货量地域分布



- 2010-2011年每季度全球主要手机品牌出货量
- 2010-2011年全球主要手机厂家出货量
- 2010-2011年全球主要手机厂家智能手机出货量
- 2011年智能手机操作系统市场占有率
- 2008-2013年全球PC用CPU与GPU 出货量
- 2008-2012年NETBOOK、iPad、平板电脑出货量
- 2007-2016全球晶圆设备投入规模
- 2011-2016年全球半导体厂家资本支出规模
- 2011-2016年全球WLP封装设备开支
- 2011-2016年全球Die封装设备开支
- 2011-2016年全球自动检测设备开支
- 2011-2012年全球TOP 10 半导体厂家资本支出额
- 2010-2013年全球半导体材料市场地域分布
- 2010-2012年全球半导体后段设备支出地域分布
- 2006-2014年OSAT市场规模
- 2007年全球IC封装类型出货量分布
- 2010年全球IC封装类型出货量分布
- 2007、2011、2015年全球封测市场技术分布



- 2012年全球OSAT产值地域分布
- 2007-2011年台湾封测产业收入
- 2010-2016年WLCSP封装市场规模
- 2010-2016年WLCSP出货量下游应用分布
- Fan-in WLCSP 2010-2016 unit CAGR by device type
- 手机CPU与GPU封装路线图
- 2010年1季度-2011年4季度 Teradyne收入与运营利润率
- 2005年1季度-2011年4季度Teradyne SOC产品新订单
- 2011年4季度 Teradyne销售额与在手订单地域分布
- 2010-2011财年Advantest订单部门分布与业务分布
- 2010-2011财年Advantest收入部门分布与业务分布
- 2010年1季度-2011年4季度Advantest订单部门分布
- 2010年1季度-2011年4季度Advantest订单地域分布
- 2010年1季度-2011年4季度Advantest收入部门分布
- 2010年1季度-2011年4季度Advantest收入地域分布
- 2000-2011年Advantest半导体测试部门销售额下游应用分布
- Advantest全球分布
- 2008-2012年全球前24大封测厂家收入



- 日月光组织结构
- 2001-2012年日月光收入与毛利率
- 2010-2011年ASE收入业务分布
- 2010年1季度-2011年4季度ASE铜线绑定Copper Wirebonding 收入
- 2010年1季度-2011年4季度ASE铜线绑定转换率
- 2010年1季度-2011年4季度ASE铜线绑定Copper Wirebonding 收入地理分布
- 2010年1季度-2011年4季度ASE铜线绑定Copper Wirebonding 收入客户分布
- 2010年1季度-2012年1季度ASE封装部门收入、毛利率
- 2010年1季度-2012年1季度ASE封装部门收入类型分布
- 2010年1季度-2012年1季度ASE测试部门收入、毛利率
- 2010年1季度-2012年1季度ASE测试部门收入业务分布
- 2010年1季度-2012年1季度ASE材料部门收入、毛利率、运营利润率
- 2010年1季度-2012年1季度ASE CAPEX与EBITDA
- 2012年1季度ASE10大客户
- 2012年1季度ASE收入下游应用
- ASE中国分布
- ASE 上海封装类型
- 2004-2011年ASE上海收入



- 2005-2011年Amkor收入与毛利率、运营利润率
- 2007-2011年Amkor收入封装类型分布
- 2008年4季度-2012年1季度Amkor收入封装类型分布
- 2008年4季度-2012年1季度Amkor出货量封装类型分布
- 2005-2011年3季度Amkor CSP封装收入与出货量
- 2011年Amkor CSP封装收入下游应用分布
- 2005-2011年3季度Amkor BGA封装收入与出货量
- 2011年Amkor BGA封装收入下游应用分布
- 2005-2011年3季度Amkor Leadframe封装收入与出货量
- 2011年3季度Amkor Leadframe封装收入下游应用分布
- 2008年1季度-2011年4季度Amkor封装业务产能利用率
- 2003-2011年硅品收入、毛利率、运营利润率
- 2005-2012年1季度硅品收入地域分布
- 2005-2012年1季度硅品收入下游应用分布
- 2005-2012年1季度硅品收入业务分布
- 硅品2006年1季度、2007年2、3季度、2011年3、4季度产能统计
- 2004-2011年星科金朋收入与毛利率
- 2006-2012年1季度星科金朋收入封装类型分布



- 2006-2012年1季度星科金朋收入下游应用分布
- 2006-2011年星科金朋收入 地域分布
- 2006-2012年PTI收入与运营利润率
- PTI工厂一览
- PTI的TSV解决方案
- 2012年1季度PTI收入业务分布
- 2012年1季度PTI收入产品分布
- 2002-2011年Greatek收入、毛利率、运营利润率
- 2007-2010年超丰电子收入技术类型分布
- 2003-2011年ChipMOS收入与毛利率
- 2010-2011年ChipMOS收入业务分布
- 2010-2011年ChipMOS收入产品分布
- 2011年ChipMOS收入客户分布
- 2006-2011年ChipMOS收入地域分布
- 2002-2012年KYEC收入与毛利率
- 2010年4月-2012年4月KYEC月度收入
- KYEC厂房分布
- KYEC TESTING PLATFORMS



- 2006-2011年Unisem收入与EBITDA
- 台塑集团组织结构
- 2006-2012年FATC收入与运营利润率
- 2010年4月-2012年4月FATC月度收入
- 2006-2012年JECT收入与运营利润率
- JCET路线图
- 2011年JCET收入地域分布
- 2007-2012年LINGSEN收入与运营利润率
- 2010年4月-2012年4月LINGSEN月度收入
- 2006-2011年Nantong Fujitsu Microelectronics收入与增幅
- 2006-2011年Nantong Fujitsu Microelectronics净利润与增幅
- 2006-2011年Nantong Fujitsu Microelectronics季度收入与增幅
- 2006-2011年Nantong Fujitsu Microelectronics季度净利润与增幅
- 2006-2011年Nantong Fujitsu Microelectronics季度毛利率
- 2006-2011年Nantong Fujitsu Microelectronics季度A、S、R&D
- 2007-2012年WALTON收入与运营利润率
- 2010年4月-2012年4月月度收入与增幅
- 2006-2012年Chipbond收入与运营利润率

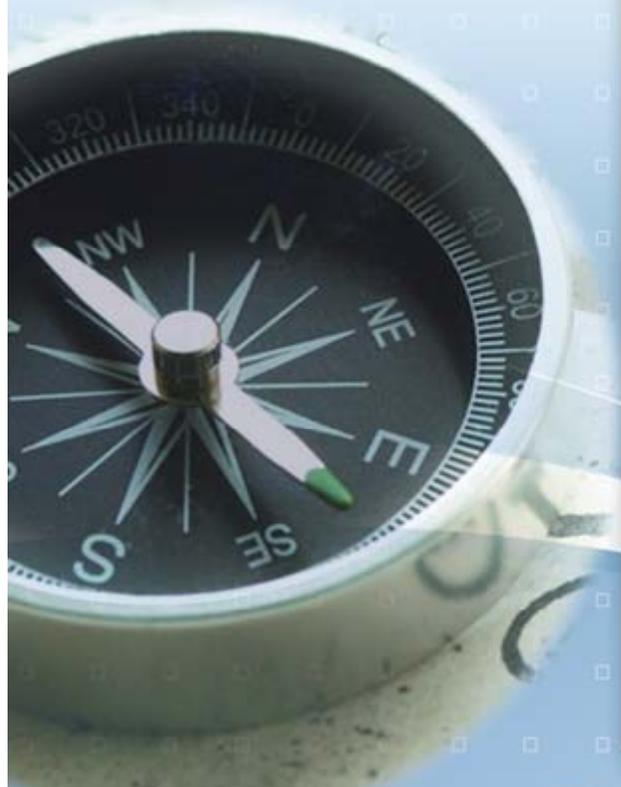


- 2010年4月-2012年4月Chipbond月度收入与增幅
- 2009年4季度-2012年1季度颀邦收入产品分布
- J-Devices Solution
- 2007-2012财年MPI收入与税前利润
- MPI收入地域分布
- Carsem 2011年1季度-2012年1季度收入产品分布
- 2006-2012年STS Semiconductor收入与运营利润率
- Signetics股东结构
- 2007-2012年Signetics收入与运营利润率
- 2010年1季度-2012年4季度 Signetics产能利用率 (Utilization) 与运营利润率
- 2011年Signetics收入产品分布
- 2011年Signetics收入客户分布
- 2006-2012年Hana Micron收入与运营利润率
- 2011年Hana Micron收入客户分布
- 2007-2012年Nepes收入与运营利润率
- 2006-2012年Nepes季度收入与运营利润率Quarterly revenues and OP trend and outlook
- 2006-2012年Nepes季度收入部门分布Quarterly sales trends and forecasts by division
- 2006-2012年Nepes季度运营利润部门分布
- 2006-2012年天水华天收入与运营利润率
- 2007-2012财年Shinko收入与净利润
- 2011-2012财年Shinko收入业务分布



购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：132页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-05		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201205/24511467.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		



如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-
82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

